



점도 (% 고체)	(Pa·s)
5	0.005
10	0.017
15	0.051
20	0.159
25	0.474
40	8.617

### 이종 물질 접착제, 임시 고정 접착제 및 씰런트로도 사용 (촉매 : 물)

EZ-BOND-WS는 수용성, 생물 분해성이며, 독성이 없는 물질입니다. 그리고, 위험성이 없는 중합제 폴리머를 주성분으로하는 접착제이며, 임시 접착의 목적으로도, 영구 접착의 목적으로든 사용가능한 접착제이다. 금속, 목재, 에폭시, 유라, 합판, 세라믹 등 기타 많은 다른물질을 서로 접착하기에 매우 유용하다.

알루미늄에 접착시켰을 때, 스퀘어 인치(25mmx25mm)당 약 50~100파운드(25~50kg)의 장력을 보장하며, 거의 모든 유기질 솔벤트와 톨루엔(toluene)을 포함하여, Methyl ethyl ketone, Jet fuel, 및 D-limonene에 이르는 화학성에 대하여 높은 저항성 및 인성을 지니고 있다. 본딩한 것이 부러진 경우에도 간단히 습기를 부여함으로 재접착이 가능하며, 85%의 높은 습윤성 환경에서 온도의 변환이 30~60°C로 순환되어도 그 접착력을 유지한다.

EZ-BOND-WS를 임시접착의 목적으로 사용한 경우에는 이 소재의 환류온도인 225°C로 다시 가열하면 간단히 떼어 낼 수 있고, 이렇게 떼어 낸 부품은 물에 몇 시간 담궈두면 깨끗이 제거됩니다.

EZ-BOND-WS는 분말로 공급되고 간단히 물로 게어서 접착제 또는 씰런트로 사용합니다.

#### ▣ 사용자 보고서

- 솔벤트에 민감한 시료의 잘고 얇게 썰기, 랩 다듬질, 광택내기등 작업에서 임시 접착제로 사용한다.
- 금속, 섬유, 세라믹, 유리 및 목재의 본딩 접착제로 사용한다.
- 가스 탱크의 씰런트로 사용한다.
- 전자현미경으로 관찰 할 시료 또는 기질의 임시고정 접착제로 사용한다.

#### ▣ 사용방법 및 순서

- 1) EZ-BOND-WS 분말을 위쪽의 점도 데이터를 참조하여 원하는 점성이 되도록 물에 용해시킵니다.  
위 데이터는 총 중량에서 파우더가 차지하는 중량비율을(%)로 표시한 것입니다.  
건조 촉진을 위해서 물 대신에 약간의 에탄올(ethanol)을 첨가하여 사용하기도 합니다.
- 2) 봇이나, 주걱 또는 나이프로 EZ-BOND를 발라주는데 0.025~0.25mm 사이의 두께로 발라야하며,  
기질을 서로 접착시킬 때 전체에 고른 압력으로 꼭 눌러서 갇혀 있는 공기를 제거해야 합니다.
- 3) 이 조립부품은 공기중에 건조시킬 수도 있고, 125°C미만의 온도로 양생시키기도 합니다.
- 4) 이 접착상태를 해체하려면 이 조립품을 225°C로 재가열하고, 잔유 흔적은 물로 씻어 냅니다.  
가열 장치가 없는 경우에는 그냥 물속에 몇 시간 담궈두었다가 분리하면 됩니다.